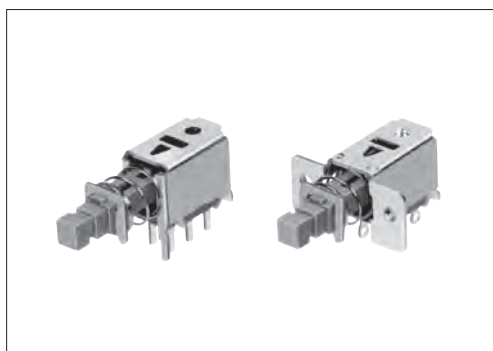


レバー高さ5.5mm、パネルに直接取付け可能タイプ。



■主な仕様

項目		仕様
最大定格／最小定格(抵抗負荷)		0.2A 30V DC/50 μ A 3V DC
接触抵抗(初期／寿命後)		20m Ω max./40m Ω max.
作動力		3 $\pm$ 1.5N
動作寿命	無負荷	10,000cycles
	負荷	10,000cycles(0.2A 30V DC)

■製品一覽

切換タイミング	移動量 (mm)	全移動量 (mm)	取付方法	回路数	動作	端子形状	最小発注単位 (PCS.)		製品番号	図番
							国内	輸出		
Non shorting	2.5	3.5	PC board	2	Latching	For PC board	700	3,500	SPPJ222200	1
					Momentary				SPPJ223200	
			M2-screw		Latching	For Lead	500	2,500	SPPJ225800	2
					Momentary				SPPJ226400	

■ 梱包仕様
バルク

製品番号	梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱／国内	1箱／輸出	
SPPJ222200 SPPJ223200	700	3,500	400×270×290
SPPJ225800 SPPJ226400	500	2,500	

■外形図

No.	形状	プリント基板取付寸法図 (A方向より見る)
1	For PC board	

SPPJ2 2.5mmストローク水平タイプ

検出

スライド

プッシュ

ロータリ

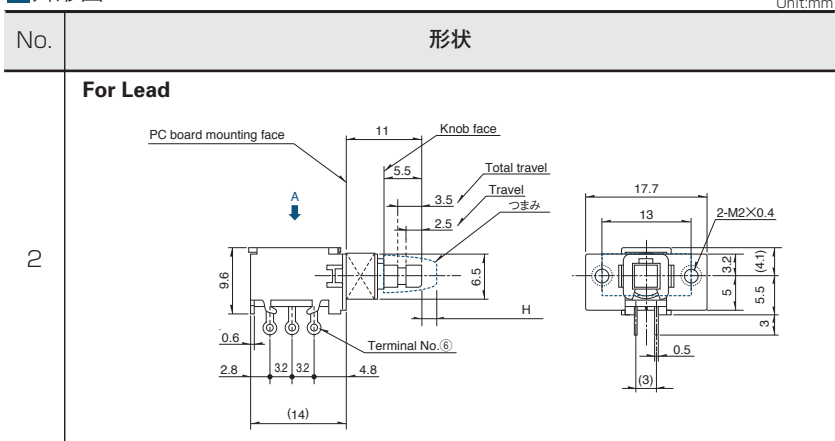
電源

ディップタイプ

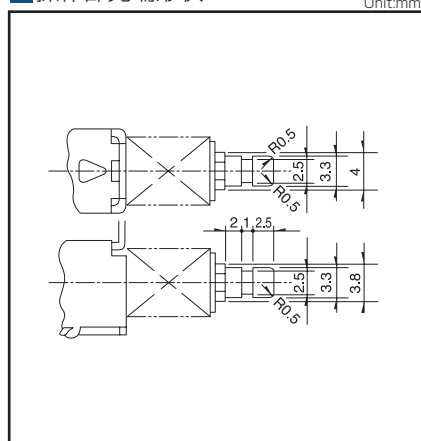
水平ソケット

バネ付

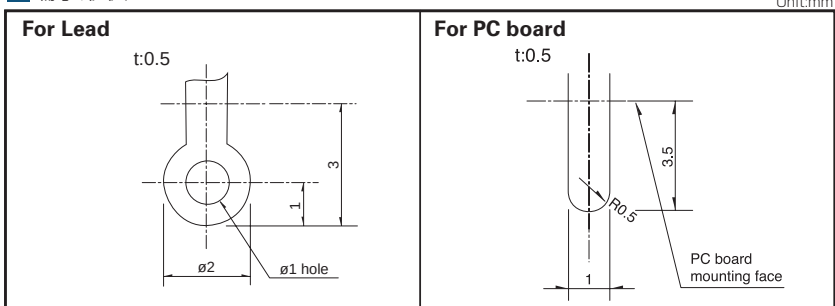
外形図



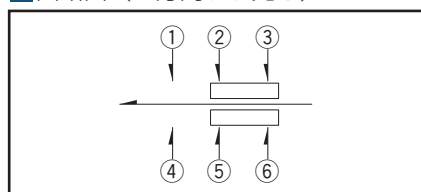
操作部先端形状



端子形状



回路図 (A方向より見る)

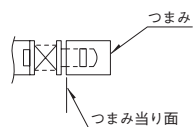


つまみ製品

つまみ外形図	Model	つまみ取り付け高さ寸法 H (mm)
角つまみ Color:Black	UE201011	5
丸つまみ Color:Black	UE200011	9

注記

スイッチに取付ける際は、つまみを接着剤で固定することをお勧めします。



プッシュスイッチ バラエティー一覧

検出

スライド

プッシュ

ロータリ

電源

ディップタイプ

ホリゾンタル

バネチカル

シリーズ			Horizontal				
			SPPJ3	SPPJ2	SPUJ	SPUN	SPUN (中電流)
写真							
外形サイズ (mm)	W	5 or 6.6		7.2	7.5	10	
	D	12			15.2 22.7	24 36	
	H	8.3	9.6	8.8	13		
移動量 (mm)			2.5		2	2.5	
全移動量 (mm)			3.5		3	3.5	
回路数			1 2	2	2 4		
使用温度範囲			-40℃ ~ +85℃		-10℃ ~ +60℃		
車載対応製品			●	●	—	—	—
ライフサイクル							
最大定格 (抵抗負荷)			0.2A 30V DC		0.1A 30V DC		1A 25V DC
最小定格 (抵抗負荷)			50μA 3V DC				—
耐久性	無負荷寿命		10,000cycles 40mΩ max.			30,000cycles 40mΩ max.	10,000cycles 40mΩ max.
	負荷寿命 最大定格負荷にて		10,000cycles 40mΩ max.				5,000cycles 40mΩ max.
電気的 性能	初期接触抵抗		20mΩ max.				
	絶縁抵抗		100MΩ min. 500V DC				
	耐電圧		500V AC for 1minute				
機械的 性能	端子強度		5N for 1minute				
	操作部 強度	作動 方向	50N	30N	50N		
		引張 方向	—	—	50N		
耐候性	耐寒性		-40℃ 96h	-20℃ 96h			
	耐熱性		85℃ 96h				
	耐湿性		40℃, 90 ~ 95%RH 96h				
ページ			111	113	115	117	

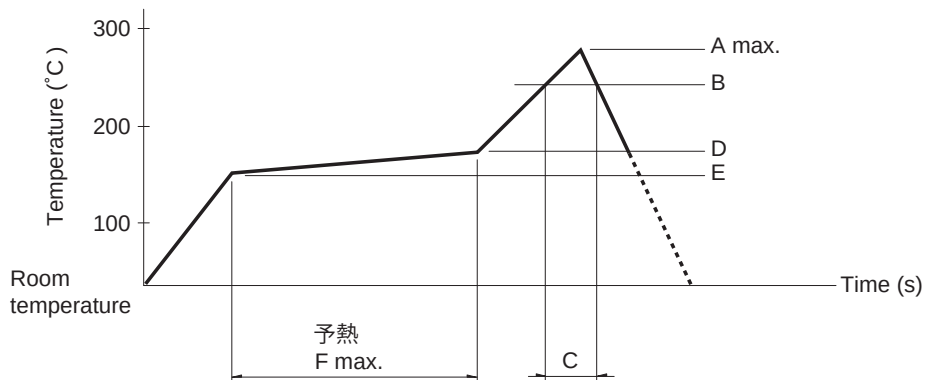
プッシュスイッチはんだ付条件 130
 プッシュスイッチご使用上の注意 131

注記

表中の●印は、シリーズ中の全ての製品が対応していることを表します。

リフロー方式の参考例

1. 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
2. 温度測定方式 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ の CA (K) または CC (T) を用い測定。位置ははんだ接合部（銅箔面）で測定。
固定方式は耐熱テープを使用する。
3. 温度プロファイル



シリーズ (リフロータイプ)	A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SPEJ	260	230	40	180	150	120
SPEF						
SPEH						

注記

1. 上記条件は、プリント基板の部品実装面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度が大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内でご使用ください。
2. リフロー槽の種類により多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

手はんだ方式の参考例

シリーズ	はんだ温度	はんだ付け時間
SPPJ3, SPPJ2, SPUN, SPUJ, SPPH4, SPPH1	350±10℃	3+1/0s
SPED2, SPED4	350±10℃	3±0.5s
SPEJ	350±10℃	4s max.
SPEF	350±5℃	3s max.
SPEH	350℃ max.	3s max.

ディップ方式の参考例

For PC board 端子タイプに適用

シリーズ	項目		ディップはんだ	
	プリヒート温度	プリヒート時間	はんだ温度	はんだ浸漬時間
SPPJ3	100℃ max.	60s max.	260±5℃	5±1s
SPUN	100℃ max.	60s max.	260±5℃	10±1s
SPUJ, SPPH4	—		260±5℃	5±1s
SPPJ2, SPPH1, SPED2, SPED4, SPEF	—		260±5℃	10±1s